

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-024

安徽铜峰电子股份有限公司关于对全资子公司——安徽合汇金源科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽合汇金源科技有限公司
- 投资金额：注册资本由 3000 万元增加至 15900 万元

一、对控股子公司增资情况概述

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司——安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）根据业务发展需要，拟将注册资本由目前的 3000 万元增加至 15900 万元，本次增资股份将全部由本公司以实物资产及货币方式进行增资。

2016 年 6 月 10 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第七届董事会第九次会议通知和会议文件，2016 年 6 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于对全资子公司——安徽合汇金源科技有限公司增资的议案。

本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：安徽合汇金源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路 6 号海恒大厦 806 室

法定代表人：程春平

注册资本：3000 万元

成立日期：2014 年 10 月 31 日

经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电子元器件及其材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进口业务。

合汇金源是由本公司全资设立，注册资本 3000 万元，目前实缴资本为 1920 万元。

三、对全资子公司增资主要内容

合汇金源目前注册资本为人民币 3000 万元，截至目前实缴资本为 1920 万元，其余 1080 万元注资尚未到位。为促进合汇金源超级电容器项目的发展，打造公司新材料、新能源及高端元器件研发产业基地建设，公司拟以四条电容薄膜生产线及相关配套设备，再以部分现金增加并补足合汇金源注册资本。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2016】第 2343 号资产评估报告，截止评估基准日 2016 年 4 月 30 日，本公司拟用于增资的四条电容薄膜生产线及相关配套设备账面价值合计 8732 万元，评估价值为 13951 万元，本次设备评估增值的原因为电容薄膜生产线的市场价格有所上涨，加上公司近年对电容薄膜生产线进行了较大幅度的升级改造，且进口设备账面价值中不含关税和进口环节，评估值中包含以上价值，故导致机器设备评估增值。

本公司拟将上述设备评估作价人民币 13951 万元，并补充注入现金 29 万元，将合汇金源注册资本增加至 15900 万元。上述拟注入设备资产运营正常，不涉及诉讼、担保、抵押等情况。

董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

四、本次增资对公司的影响

本公司将上述相关实物资产注入到下属全资子公司合汇金源，将有利于公司新材料、新能源及高端元器件产业的经营与发展，实现相关资产的有效配置，也可以加快合汇金源超级电容器项目的发展，优化合汇金源的财务结构，提高抗风险能力。本次增资是以公司资产投资注入到全资子公司，不影响公司主业的运行，对本公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日